

KSRA-08ZQDJ558 - CCB 2799 Final Notice: Qualification of CuPdAu bond wire for selected products of 200K wafer technology available in 16L QFN (3x3x0.9mm) package at NSEB assembly site.

Affected Catalog Part Numbers (CPN)

PCN_KSRA-08ZQDJ558
CATALOG_PART_NBR
PIC16F1503-E/MG
PIC16F1503-I/MG
PIC16F1503-I/MG031
PIC16F1503-I/MGC02
PIC16F1503T-E/MG
PIC16F1503T-E/MG033
PIC16F1503T-E/MG039
PIC16F1503T-I/MG
PIC16F1503T-I/MG027
PIC16F1503T-I/MG028
PIC16F1503T-I/MG029
PIC16F1503T-I/MG030
PIC16F1503T-I/MG031
PIC16F1503T-I/MG032
PIC16F1503T-I/MG035
PIC16F1503T-I/MG037
PIC16F1503T-I/MG043
PIC16F1503T-I/MG044
PIC16F1503T-I/MG048
PIC16F1503T-I/MGC02
PIC16LF1503-E/MG
PIC16LF1503-I/MG
PIC16LF1503-I/MG022
PIC16LF1503-I/MGC02
PIC16LF1503T-E/MG
PIC16LF1503T-I/MG
PIC16LF1503T-I/MG022
PIC16LF1503T-I/MGC02
UTC2000/MG
UTC2000-I/MG
UTC2000T/MG
UTC2000T-I/MG